2026-2031年全球及中国芯片设计（半导体IC设计）行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：芯片设计综述/产业画像/研究说明
1.1 芯片设计产业综述
1.1.1 芯片设计的界定
1、芯片设计的定义
2、芯片设计的流程
1.1.2 芯片设计的价值
1.1.3 芯片设计所处行业
1.1.4 芯片设计市场监管
1.1.5 芯片设计标准规范
1.2 芯片设计产业画像
1.2.1 芯片设计产业链结构示意图
1.2.2 芯片设计产业链生态全景图
1.2.3 芯片设计产业链区域热力图
1.3 芯片设计研究说明
1.3.1 本报告研究范围界定
1.3.2 本报告权威数据来源
1.3.3 本报告研究统计方法
——现状篇——
第2章：全球芯片设计行业发展现状分析
2.1 全球芯片设计行业发展历程
2.2 全球芯片设计市场规模体量
2.3 全球芯片设计区域发展格局
2.4 全球芯片设计重点区域分析——美国
2.5 全球芯片设计市场竞争态势
2.5.1 全球芯片设计市场竞争格局
2.5.2 全球芯片设计市场集中度
2.5.3 全球芯片设计并购交易态势
2.5.4 全球芯片设计投融资动态
2.6 全球半导体产业及芯片设计
2.6.1 全球半导体产业发展现状分析
2.6.2 全球芯片设计细分市场概况
2.6.3 全球芯片设计细分领域企业
2.7 国外芯片设计发展经验借鉴
2.8 全球芯片设计市场前景预测
2.9 全球芯片设计发展趋势洞悉
第3章：中国芯片设计行业发展现状分析
3.1 中国芯片设计行业发展历程
3.2 中国芯片设计市场规模体量
3.3 中国芯片设计商业运营模式
3.3.1 IDM模式
3.3.2 Fabless模式
3.3.3 Fundary模式
3.4 中国芯片设计企业数量变化
3.5 中国芯片设计能力/服务水平
3.6 中国芯片设计招标投标采购
3.6.1 芯片设计招标投标模式/政策
3.6.2 芯片设计招标投标/采购汇总
3.6.3 芯片设计招标投标/采购规模

3.6.4 芯片设计招标投标/采购分析
3.7 中国芯片设计行业经营效益
3.7.1 中国芯片设计销售过亿企业数量
3.7.2 中国芯片设计销售过亿企业分布
3.7.3 中国芯片设计企业盈利比例变化
3.7.4 中国芯片设计企业的毛利率水平
3.8 中国芯片设计行业发展痛点/挑战
第4章：中国芯片设计市场竞争及投融资
4.1 中国芯片设计行业竞争对手分析『同业竞争者』
4.1.1 中国芯片设计现有直接竞争者的竞争程度
4.1.2 中国芯片设计潜在/跨界竞争者的进入威胁
4.1.3 中国芯片设计替代品竞争者份额争夺威胁
4.2 中国芯片设计行业竞争态势矩阵（CPM矩阵）
4.2.1 中国芯片设计企业关键成功因素KSF
4.2.2 中国芯片设计行业竞争者的竞争势头
4.2.3 中国芯片设计行业竞争者的战略集群
4.3 中国芯片设计市场竞争结构分析/差异化竞争
4.3.1 中国芯片设计行业所处生命周期阶段
4.3.2 中国芯片设计行业市场集中度『CRn』
4.3.3 中国芯片设计行业产品差异化程度
4.4 中国芯片设计市场竞争梯队分布
4.5 中国芯片设计市场竞争格局分析
4.6 中国芯片设计企业投资并购态势
4.6.1 中国芯片设计企业投资布局
4.6.2 中国芯片设计企业兼并重组
4.7 中国芯片设计企业融资情况解读
4.7.1 中国芯片设计企业融资渠道
4.7.2 中国芯片设计企业IPO动态
4.7.3 中国芯片设计企业融资事件
4.7.4 中国芯片设计企业融资规模
4.7.5 中国芯片设计热门融资赛道
4.8 中国芯片设计企业国内外竞争力
4.8.1 中国市场：芯片设计企业VS外资企业
4.8.2 海外市场：中国芯片设计企业全球竞争力
4.9 中国芯片设计行业国产替代进程
4.9.1 中国芯片设计国产化进程及国产化率
4.9.2 中国芯片设计细分赛道国产替代空间
第5章：中国芯片设计技术进展及供应链
5.1 芯片设计竞争力及进入壁垒
5.1.1 芯片设计核心竞争力/护城河——人才+架构+工具
5.1.2 芯片设计技术壁垒/进入壁垒
5.2 中国芯片设计人才缺口明显
5.2.1 中国芯片设计人才短缺现状
5.2.2 中国芯片设计人才缺口原因
1、芯片设计对人才要求高
2、芯片设计人才培养周期长
3、芯片设计人才流失率高
5.2.3 芯片设计企业人员规模分布
5.2.4 中国芯片设计从业人员规模
5.2.5 中国芯片设计人均产值规模
5.2.6 中国芯片设计企业研发人员
5.3 中国芯片设计研发投入不足
5.3.1 芯片设计企业研发投入力度/强度
5.3.2 芯片设计企业研发项目/投入方向
5.3.3 芯片设计知识产权统计/专利技术
5.3.4 芯片设计科研创新动态/论文发表
5.3.5 芯片设计技术研发方向/未来重点
5.4 中国芯片设计产业生态不完善
5.4.1 中国芯片设计产业生态有待继续完善

5.4.2 中国芯片设计企业人力成本不断提高
5.5 供应链：芯片架构/指令级架构
5.5.1 芯片架构/指令级架构概述
5.5.2 芯片架构/指令级架构市场概况
5.5.3 芯片架构/指令级架构——X86
1、X86概述
2、X86市场概况
3、X86供应商格局
5.5.4 芯片架构/指令级架构——ARM架构
1、ARM架构概述
2、ARM架构市场概况
3、ARM架构供应商格局
5.5.5 芯片架构/指令级架构——RISC-V
1、RISC-V概述
2、RISC-V市场概况
3、RISC-V供应商格局
5.5.6 芯片架构/指令级架构——MIPS架构
1、MIPS架构概述
2、MIPS架构市场概况
3、MIPS架构供应商格局
5.6 供应链：芯片设计EDA软件
5.6.1 芯片设计EDA软件概述
5.6.2 芯片设计EDA软件市场概况
5.6.3 芯片设计EDA软件供应商格局
5.7 供应链：半导体IP授权/IP核
5.7.1 半导体IP授权/IP核概述
5.7.2 半导体IP授权/IP核市场概况
5.7.3 半导体IP授权/IP核供应商格局
5.8 供应链：半导体设计仿真/验证
5.8.1 半导体设计模拟仿真概述
5.8.2 半导体设计模拟仿真市场概况
5.8.3 芯片设计后端验证及第三方检测
5.9 供应链：半导体版图设计/掩膜版制造
5.9.1 半导体版图设计概述
5.9.2 半导体版图设计软件
5.9.3 光刻掩膜版（光罩）市场概况
5.10 芯片设计的供应链管理挑战
第6章：中国芯片设计细分市场发展分析
6.1 芯片设计细分产品综合对比
6.2 芯片设计行业细分市场概况
6.2.1 芯片设计细分市场概况
6.2.2 芯片设计细分市场结构
6.3 芯片设计细分市场：模拟IC芯片设计
6.3.1 模拟IC芯片设计概述
6.3.2 模拟IC芯片设计市场概况
6.3.3 模拟IC芯片设计竞争格局
6.3.4 模拟IC芯片设计发展前景
6.4 芯片设计细分市场：逻辑IC芯片设计
6.4.1 逻辑IC芯片设计概述
6.4.2 逻辑IC芯片设计市场概况
6.4.3 逻辑IC芯片设计竞争格局
6.4.4 逻辑IC芯片设计发展前景
6.5 芯片设计细分市场：功率半导体设计
6.5.1 功率半导体设计概述
6.5.2 功率半导体设计市场概况
6.5.3 功率半导体设计竞争格局
6.5.4 功率半导体设计发展前景
6.6 芯片设计细分市场：射频芯片设计
6.6.1 射频芯片设计概述

6.6.2 射频芯片设计市场概况
6.6.3 射频芯片设计竞争格局
6.6.4 射频芯片设计发展前景
6.7 芯片设计细分市场：存储芯片设计
6.7.1 存储芯片设计概述
6.7.2 存储芯片设计市场概况
6.7.3 存储芯片设计竞争格局
6.7.4 存储芯片设计发展前景
6.8 芯片设计细分市场战略地位分析
第7章：中国芯片设计细分应用市场分析
7.1 芯片设计客户类型及需求特征
7.1.1 中国芯片设计客户类型
7.1.2 中国芯片设计需求特征
7.1.3 芯片设计客户议价能力
7.2 芯片设计应用场景及领域分布
7.2.1 芯片设计潜在应用场景
7.2.2 芯片设计应用领域分布
7.3 芯片设计应用场景：通信芯片设计
7.3.1 通信领域芯片设计需求概述
7.3.2 通信领域芯片设计市场现状
7.3.3 通信领域芯片设计需求潜力
7.4 芯片设计应用场景：消费电子芯片设计
7.4.1 消费电子领域芯片设计需求概述
7.4.2 消费电子领域芯片设计市场现状
7.4.3 消费电子领域芯片设计需求潜力
7.5 芯片设计应用场景：计算机
7.5.1 计算机领域芯片设计需求概述
7.5.2 计算机领域芯片设计市场现状
7.5.3 计算机领域芯片设计需求潜力
7.6 芯片设计细分应用战略地位分析
第8章：全球及中国芯片设计企业案例解析
8.1 全球及中国芯片设计企业梳理对比
8.2 全球芯片设计企业案例分析【不分先后，可指定】
8.2.1 英伟达
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业芯片设计业务布局
4、企业芯片设计在华布局
8.2.2 高通
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业芯片设计业务布局
4、企业芯片设计在华布局
8.2.3 博通
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业芯片设计业务布局
4、企业芯片设计在华布局
8.2.4 超威
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业芯片设计业务布局
4、企业芯片设计在华布局
8.2.5 联发科
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业芯片设计业务布局
4、企业芯片设计在华布局
8.3 中国芯片设计企业案例分析【不分先后，可指定】

8.3.1 紫光国芯微电子股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.2 上海韦尔半导体股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.3 华润微电子有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.4 三安光电股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.5 斯达半导体股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局

7、企业发展战略&优劣势
8.3.6 海光信息技术股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.7 苏州纳芯微电子股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.8 兆易创新科技集团股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.9 江苏卓胜微电子股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及投融资
（1）经营情况/营业收入
（2）产品结构/主营业务
（3）销售区域/国内国外
（4）融资历程/对外投资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
8.3.10 扬州扬杰电子科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况及融资
3、企业经营资质/能力资质
4、企业研发投入/专利技术
5、企业芯片设计能力/业务布局
6、企业芯片设计应用/客户布局
7、企业发展战略&优劣势
——展望篇——
第9章：中国芯片设计行业政策环境/PEST/SWOT

9.1 中国芯片设计行业政策汇总解读『P』
9.1.1 中国芯片设计行业政策汇总
9.1.2 中国芯片设计行业发展规划
9.1.3 中国芯片设计重点政策解读
9.1.4 各地芯片设计政策规划汇总
9.1.5 各地芯片设计的政策热力图
9.1.6 各地芯片设计发展目标解读
9.2 中国芯片设计行业经济社会环境
9.2.1 中国芯片设计经济环境分析『E』
9.2.2 中国芯片设计社会环境分析『S』
9.3 中国芯片设计行业PEST环境总结
9.4 中国芯片设计行业SWOT分析图
第10章：中国芯片设计行业发展潜力及前景展望
10.1 中国芯片设计行业发展潜力评估
10.2 中国芯片设计行业未来关键增长点
10.3 中国芯片设计行业发展前景预测
10.4 中国芯片设计行业发展趋势洞悉
10.4.1 中国芯片设计行业整体发展趋势
10.4.2 中国芯片设计行业细分市场趋势
10.4.3 中国芯片设计行业技术创新趋势
10.4.4 中国芯片设计行业市场竞争趋势
10.4.5 中国芯片设计行业市场供需趋势
第11章：中国芯片设计行业发展机遇及策略建议
11.1 中国芯片设计行业投资风险预警
11.1.1 中国芯片设计行业投资风险预警
11.1.2 中国芯片设计行业投资风险应对
11.2 中国芯片设计行业投资机遇分析——全产业链配套
11.2.1 不足：芯片设计产业链薄弱点投资机会
11.2.2 欠缺：芯片设计产业链空白点投资机会
11.3 中国芯片设计行业投资机遇分析——细分领域布局
11.3.1 中游：芯片设计细分产品服务布局机会
11.3.2 下游：芯片设计细分应用领域布局机会
11.4 中国芯片设计行业投资机遇分析——优势区域布局
11.4.1 国内：芯片设计行业优势区域投资机会
11.4.2 海外：芯片设计海外投资布局/出海机会
11.5 中国芯片设计行业投资价值评估
11.6 中国芯片设计行业投资策略建议
11.7 中国芯片设计行业可持续发展建议

图表目录

图表1：芯片设计的定义
图表2：芯片设计的流程
图表3：芯片设计的价值
图表4：芯片设计所处行业
图表5：芯片设计监管体系
图表6：芯片设计监管机构
图表7：芯片设计标准体系
图表8：芯片设计标准汇总
图表9：芯片设计产业链结构示意图
图表10：芯片设计产业链生态全景图
图表11：芯片设计产业链区域热力图
图表12：本报告研究范围界定
图表13：本报告权威数据来源
图表14：本报告研究统计方法
图表15：全球芯片设计行业发展历程

图表16：全球芯片设计市场规模体量
图表17：全球芯片设计区域发展格局
图表18：美国芯片设计行业发展概况
图表19：全球芯片设计市场竞争格局
图表20：全球芯片设计市场集中度
图表21：全球芯片设计并购交易态势
图表22：全球芯片设计投融资动态
图表23：全球半导体产业发展现状分析
图表24：全球芯片设计细分市场概况
图表25：全球芯片设计细分领域企业
图表26：国外芯片设计发展经验借鉴
图表27：全球芯片设计市场前景预测（2026-2031年）
图表28：全球芯片设计发展趋势洞悉
图表29：中国芯片设计行业发展历程
图表30：中国芯片设计市场规模体量
图表31：2016-2025年中国集成电路设计业销售额（单位：亿元，%）
图表32：中国芯片设计企业数量变化
图表33：中国芯片设计能力/服务水平
图表34：中国芯片设计企业业务能力
图表35：中国芯片设计招标投标模式/政策
图表36：中国芯片设计招标投标/采购汇总
图表37：中国芯片设计招标投标/采购规模
图表38：中国芯片设计集中招标采购分析
图表39：中国芯片设计企业的毛利率水平
图表40：中国芯片设计行业发展痛点/挑战
图表41：中国芯片设计现有直接竞争者的竞争程度
图表42：中国芯片设计潜在竞争者的进入威胁
图表43：中国芯片设计替代品竞争者份额争夺威胁
图表44：中国芯片设计关键成功因素KSF
图表45：中国芯片设计行业竞争者的竞争势头
图表46：中国芯片设计行业竞争者的战略集群
图表47：中国芯片设计行业所处生命周期阶段
图表48：中国芯片设计行业市场集中度『CRn』
图表49：中国芯片设计市场竞争梯队分布
图表50：中国芯片设计市场竞争梯队分布
图表51：中国芯片设计市场竞争格局
图表52：中国芯片设计企业投资布局
图表53：中国芯片设计企业兼并重组
图表54：中国芯片设计企业融资渠道
图表55：中国芯片设计企业IPO动态
图表56：中国芯片设计企业融资事件
图表57：中国芯片设计企业融资规模
图表58：中国芯片设计热门融资赛道
图表59：芯片设计外企在华市场竞争力
图表60：芯片设计外企在华布局动态
图表61：芯片设计核心竞争力/护城河
图表62：芯片设计技术壁垒/进入壁垒
图表63：芯片设计企业研发人员数量
图表64：芯片设计企业研发投入力度/强度
图表65：芯片设计企业研发项目/投入方向
图表66：芯片设计知识产权统计/专利技术
图表67：芯片设计科研创新动态/论文发表
图表68：芯片设计技术研发方向/未来重点
图表69：中国芯片设计产业生态有待继续完善
图表70：中国芯片设计企业人力成本不断提高
图表71：芯片架构/指令级架构概述
图表72：芯片架构/指令级架构市场概况
图表73：芯片设计EDA软件概述
图表74：芯片设计EDA软件市场概况

图表75：半导体IP授权/IP核概述
图表76：半导体IP授权/IP核市场概况
图表77：芯片设计后端验证及第三方检测
图表78：芯片设计的供应链管理挑战
图表79：芯片设计细分产品综合对比
图表80：芯片设计细分市场概况
图表81：芯片设计细分市场结构
图表82：模拟IC芯片设计概述
图表83：模拟IC芯片设计市场概况
图表84：模拟IC芯片设计竞争格局
图表85：模拟IC芯片设计发展趋势
图表86：逻辑IC芯片设计概述
图表87：逻辑IC芯片设计市场概况
图表88：逻辑IC芯片设计竞争格局
图表89：逻辑IC芯片设计发展前景
图表90：功率半导体设计概述
图表91：功率半导体设计市场概况
图表92：功率半导体设计竞争格局
图表93：功率半导体设计发展前景
图表94：芯片设计细分市场战略地位分析
图表95：芯片设计下游客户类型
图表96：芯片设计市场需求特征
图表97：芯片设计潜在应用场景
图表98：芯片设计应用领域分布
图表99：通信领域芯片设计需求概述
图表100：通信领域芯片设计市场现状
图表101：通信领域芯片设计需求潜力
图表102：消费电子领域芯片设计需求概述
图表103：消费电子领域芯片设计市场现状
图表104：消费电子领域芯片设计需求潜力
图表105：计算机领域芯片设计需求概述
图表106：计算机领域芯片设计市场现状
图表107：计算机领域芯片设计需求潜力
图表108：芯片设计细分应用波士顿矩阵分析
图表109：全球及中国芯片设计企业梳理对比
图表110：全球芯片设计企业案例分析说明
图表111：英伟达基本情况
图表112：英伟达经营情况
图表113：英伟达芯片设计业务布局
图表114：英伟达芯片设计在华布局
图表115：高通基本情况
图表116：高通经营情况
图表117：高通芯片设计业务布局
图表118：高通芯片设计在华布局
图表119：博通基本情况
图表120：博通经营情况
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！